

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

503

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.07.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	306		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		4
C-RS-FR4-DS-1.20mm-070+070-TG150-HF	50200955	70	L2	5
		1060		
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	309		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	9

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1885 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik